

电子行业跟踪周报

海外算力产业链一季报点评：AI 驱动量价齐升，上游涨价景气有望贯穿全年

增持（维持）

2026 年 05 月 05 日

证券分析师 陈海进

执业证书：S0600525020001

chenhj@dwzq.com.cn

研究助理 解承堯

执业证书：S0600125020001

xiechy@dwzq.com.cn

投资要点

■ PCB 板块：AI 驱动量价齐升，原材料涨价冲击分化

2026 年一季度，AI 服务器 PCB 企业业绩全面兑现高景气。生益电子营收同比+52.6%、净利润同比+122.2%，毛利率大幅提升 5.3 个百分点至 35.2%，公司披露 AI 算力产品 2025 年同比增长 242%，服务器收入占比超 60%。沪电股份营收同比+53.9%、净利润同比+62.9%，公司明确受益于“高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板结构性需求”，Q1 即宣布逾 170 亿元扩产计划。深南电路营收同比+37.9%，净利润同比+73.01%。广合科技营收同比+71.4%、净利润同比+63.3%。胜宏科技营收同比+28%，净利润同比+40%。AI 服务器驱动 PCB 需求持续旺盛，供不应求格局支撑量价齐升。

CCL 涨价有冲击，但呈现显著分化。景旺电子 Q1 净利润同比-28.4%，毛利率同比下滑 2.0 个百分点，主因汽车电子 PCB 占比较高、原材料涨价传导滞后影响。超颖电子 Q1 由盈转亏，泰国工厂尚处爬坡期亦有影响。

■ CCL 板块：提价利润弹性显著释放，全年景气延续

CCL 板块 2026 年 Q1 业绩全面超预期，提价带来的利润增厚显著。南亚新材营收同比+92.4%、净利润同比+610.8%，毛利率同比+5.2 个百分点。生益科技营收+45.1%、净利润+105.5%，高速覆铜板加速放量，经营现金流同比翻倍。金安国纪毛利率从 10.8%跃升至 26.4%，同比+15.7 个百分点，公司在互动平台明确表示“原材料成本的上涨能够有序的向下传导”。

南亚新材表示，本轮涨价系在 2025 年年底启动，“主要受原材料成本暴涨加之 AI 驱动的结构性能重塑叠加行业产能结构调整所带来”。生益科技在 2 月互动平台回复投资者称“会根据市场需求及原材料价格变化，及时调整经营策略，采取相关措施应对”。我们认为本轮 AI 需求驱动叠加产品结构调整影响下的 CCL 涨价持续性强，有望增厚 CCL 企业全年业绩。

■ PCB 上游材料：产能挤压叠加涨价，利润增厚显著

电子铜箔端，铜冠铜箔 Q1 营收同比+32.0%、净利润同比+2138.2%，公司公告明确指出“营收增长主要是铜箔产品售价上涨所致”。德福科技 Q1 营收+73.5%、净利润+708.9%，公司公开确认对锂电客户启动提价，标志着持续两年的锂电铜箔低价周期被打破，电子、锂电铜箔全系列已进入提价周期。

电子布端，宏和科技 Q1 营收同比+79.7%、净利润同比+354.2%，电子级玻璃纤维布平均售价同比+116.9%，毛利率跃升至 55.7%（同比+27.6 个百分点），公司公告指出“普通 E 玻璃纤维电子布销售数量和单价上升以及特种电子布销售数量增加带动营业收入及净利润增加”。受益于 AI 需求驱动的产能挤压和涨价效应，PCB 上游材料企业利润得到大幅增厚。

■ 光芯片板块：供不应求格局持续，国产替代加速

光模块需求持续增长驱动光芯片高景气。源杰科技 Q1 营收同比+320.9%、净利润同比+1153.1%，Q1 单季扣非后归母净利润已超 2025 年全年。东山精密 Q1 营收同比+52.7%、净利润同比+143.5%，公司光

行业走势



相关研究

模块业务抓住了行业爆发和客户订单加急的机会，较去年同期实现了收入翻倍，对 Q1 收入和利润形成了核心贡献。长光华芯 Q1 营收同比+37.81%，增长主要源于光通信等业务的增长，公司在互动平台表示“已有海外光模块大厂在验证公司多款芯片且验证顺利”。

全球光芯片供需缺口巨大，国内厂商凭借成本优势和快速产能响应，陆续进入海外光模块供应链，供不应求景气持续旺盛。

■ 铜连接：AI 架构升级驱动用量增长，高速铜缆进入放量期

英伟达 GB200/GB300 及 Vera Rubin NVL144 超节点架构推动铜连接用量大幅增长，沃尔核材单通道 224G 高速通信线已实现量产。立讯精密 Q1 营收+35.8%、净利润+20.2%，224G 高速互连方案已实现商用，CPC 铜连接产品预计 2027 年向首家客户批量交付。瑞可达 400G/800G 产品已实现小批量交付，泰国工厂 Q1 开始海外生产交付。

“光铜并进”成为行业共识，机柜内短距场景铜连接凭借低功耗、低成本、低延迟优势不可替代。立讯精密明确提出 Scale Up 网络以铜连接/CPC 主导，Scale Out 网络以 CPO 主导。随着超节点技术渗透率提升和 NVLink 6 代带宽翻倍，铜连接使用量有望进一步增长，全年高速铜缆业务有望进入加速放量期。

■ 产业链相关公司：

PCB：胜宏科技，深南电路，沪电股份，生益电子，广合科技等

CCL：生益科技，南亚新材，金安国纪，华正新材等

PCB 上游材料：铜冠铜箔，隆扬电子，宏和科技，菲利华等

光芯片：源杰科技，长光华芯，东山精密等

铜连接：立讯精密，沃尔核材，瑞可达等

■ 风险提示：供应链波动风险，下游需求不及预期，行业竞争加剧。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的,应当注明出处为东吴证券研究所,并注明本报告发布人和发布日期,提示使用本报告的风险,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的,应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期(A 股市场基准为沪深 300 指数,香港市场基准为恒生指数,美国市场基准为标普 500 指数,新三板基准指数为三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的),北交所基准指数为北证 50 指数),具体如下:

公司投资评级:

- 买入: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上;
- 增持: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间;
- 中性: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间;
- 减持: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间;
- 卖出: 预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级:

- 增持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对强于基准 5%以上;
- 中性: 预期未来 6 个月内,行业指数相对基准-5%与 5%;
- 减持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况,如具体投资目的、财务状况以及特定需求等,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码: 215021

传真: (0512) 62938527

公司网址: <http://www.dwzq.com.cn>